MENU

SEARCH

INDEX

JAPANESE

LEGAL STATUS

1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

56-000834

(43)Date of publication of

07.01.1981

application:

(51)Int.Cl.

C08K 3/22

C08K 7/18

(21)Application

54-074595

(71)

SHOWA DENKO KK

number:

Applicant:

(22) Date of filing:

15.06.1979

(72)Inventor:

SAKAIDA TOSHIRO

OISHI NAOAKI

HASEGAWA HIKARI

YAMAGUCHI KATSUNOBU

(54) ADDITIVE FOR HIGH-MOLECULAR MATERIAL

(57) Abstract:

PURPOSE: Titled additive which enables high-molecular materials to produce molded products having excellent thermal conductivity, moldability and mechanical properties, comprising three kinds of aluminas having a specific shape factor and different particle diameters.

CONSTITUTION: An additive is obtained by adding to hydrated alumina, an α - alumina seed crystal having a particle diameter of below $100~\mu$; subjecting the resulting mixture to hydrothermal treatment under conditions of a pressure of 150W 500Kg/cm2, a temperature of 370W500°C and a treating time of 2W10hr, while avoiding forming fresh crystal nuclei of α -alumina; then, disintegrating the product in a powder treating apparatus, thereby producing α -alumina powder having a shape factor of 1.0W1.4; screening the α -alumina powder into (A) α -alumina powder, particle diameter $\leq 3~\mu$, (B) α -alumina powder, particle diameter of 3W20 μ and (C) α -alumina powder $\geq 20~\mu$; and mixing the three kinds of aluminas so as to provide a volume ratio, B/A, of 0.25W5 and a volume ratio, C/(A+B), of 0.1W0.4. The additive obtained is added to a high-molecular material, in an amount of 70W78vol%.

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—834

50 Int. Cl.3

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和56年(1981) 1月7日

C 08 K 3/22 7/18

CALCAL

6911—4 J 6911-4 J

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

函高分子物質用配合剤

20特

22出

願 昭54—74595

願 昭54(1979)6月15日

明者坂井田敏郎 72発

横浜市港南区野庭町604ノ1

明 者 大石直明 70発

町田市玉川学園七丁目27番60号

明 者 長谷川光

習志野市谷津七丁目7番地

明 者 山口勝信 ⑫発

川崎市中原区北谷町95の1

願 人 昭和電工株式会社 ①出

東京都港区芝大門1丁目13番9

個代 理 人 弁理士 菊地精一

明

1. 発明の名称

高分子物質用配合剤

2. 特許請求の範囲

3 μ以下の粒度のαーアルミナをΑ、3 μより 大きく20μより小さい粒度のαーアルミナをΒ および20μ以上の粒度のαーアルミナをCとし たとき、容量比でB/A=0.25~5およびC/ (A+B)=0.1~0.4となるような粒度分布を 有し、かつこれらのαーアルミナの形状因子が1.0 ~ 1.4 であることを特徴とする高分子物質用配合 剤。

3. 発明の詳細な説明

本発明は熱伝導性付与する高分子物質用配合剤 に関する。 さらにくわしくは、 粒度分布が特定な 範囲を有し、かつ形状因子が 1.0 ~ 1.4 である α ーアルミナ粒子からなる高分子物質用配合剤に関

電子装置のマイクロ化および高密度化の進展に ともない、発生した熱をいかにして外部へ伝達ま たは冷却させるかが装置の能力を左右する状況と なっている。

近年、電子部品の絶縁基板、封止剤、放熱シー トなどに「合成樹脂およびゴム状物」(以下「高 分子物質 」と云う)の成形物が広く用いられてい る。しかしながら、これらの成形物は高分子物質 単味のままでは熱伝導率が小さく、したがって放 熱効果が乏しいことにより、蓄熱による回路素子 に損傷を与え易い。

以上のことから、髙分子物質の成形体の熱伝導 性を改善するため、大きい熱伝導率を有する電気 絶縁性無機配合剤を配合することが一般に行なわ れているが、これらの配合剤の配合割合を上げて いていくにともない、得られる成形物の機械的性 質が低下していくばかりでなく、成形物を製造す るさいに成形加工性も低下するため、これらの配 合剤の配合による高分子物質の成形体の高熱伝導 化には、おのずから限界があった。

以上のことから、本発明者らは、これらの欠点 の改良された配合剤を得るために種々探索した結 果、特殊な粒度分布を有し、かつ形状因子が1.0~1.4であるαーアルミナ粉末を高分子物質に配合することにより、該αーアルミナ粉末の配合比率を上げたとしても、配合物(組成物)の機械的性質が低下せず、かつ配合物を用いて成形物を製造するさいに加工性がすぐれていることを見出し、本発明に到達した。

一般に用いられているαーアルミナ粉末は高分子物質に対する高配合(高充塡)が容易である反面、得られる組成物の高熱伝導率化に限界があった。本発明者らは、特殊なαーアルミナ粉末、オカち形状因子が1.0~1.4であり、かつあるりでを分布を有するαーアルミナ粉末の粒度分布を有するαーアルミナ粉末の粒度分布をも改善されることも見出した。この理由として、ではなが、その理由として、ではなが、その理由として、この種の粒度分布を有するαーアルミナ粉末が高

(3)

原料のアルミナ水和物中に種結晶としてαーア ルミナ(コランダム)微粒を添加して新たなαー アルミナ結晶核の生成を防ぎつつ水熱処理を行う 点に関しては我々の先願である特開昭52-15 498の方法と本質的に変るところはない。即ち、 アルミナ水和物は水酸化アルミニウム(三水和物) ベーマイト(一水和物)のいずれでもよく、また アルミナ水和物に添加するα-アルミナ種結晶の 量は、三水和物換算のアルミナ水和物の総重量を WR(8) とし、添加するα-アルミナ種結晶の総面 積を A 8 (cd) とすると、WR/A 8 値が 0.059/ cd以下であることが好ましく、 0.0 2 9 / cd以下 が特に好ましい。ととでA8(cd)はJIB R 6002に準ずる拡大顕微鏡法による粒径を用い て求めることができる。その他アルミナ水和物と αーアルミナ微粒とを十分によく混合すること、 また水熱処理に際しては原料中の温度差をなるべ く小さくすることが望ましいことも前記先顧と同 様である。水熱処理の温度、圧力は370~500 C、 1 5 0 ~ 5 0 0 M/ ddの範囲が適当であり、

分子物質中に最も密に分散する最密充填構造をとりやすく、配合剤として使われるα-アルミナ粉末の高熱伝導性が効果的に寄与するためと考えられる。

本発明において使われる α -アルミナ粉末の粒度分布は、 3μ 以下の粒度の α -アルミナ粉末をA、 3μ より大きく 20μ より小さいものを B および 20μ 以上のものを C としたとき、容量比で B / A = $0.25\sim5$ および C / (A + B) = 0.1 ~ 0.4 であるものである。また、形状因子が 1.0 ~ 1.4 であるものである。

ことでいう形状因子とは、JIS R6002 の顕微鏡拡大法で定める各粒の長径とこれに直交 する短径の比(長径/短径)の平均値より算出し て求める。測定粒子数は200個を基準とする。 従って、完全な球形粒のみであれば、形状因子は 1となり、この形状因子が1に近い粒程、より球 形に近いといえる。

とのような形態のαーアルミナ粉末は次のごと き方法によって作られる。

(4)

処理時間は2~10時間が適当である。

これらの条件で水熱処理を行えば、生成αーアルミナ粒の粒径制御も比較的容易にできることは特開昭 5 2-1 5 4 9 8 号に述べられているとおりである。

なお、ここでいう微細をαーアルミナ種結晶とは、パイヤーアルミナ、電融アルミナの粉砕微粒等であり、その粒度は特に制限はないが、成長率を同一にして比較した場合、大きい粒程時間がかかるので、経済性を考慮すると、αーアルミナ種結晶の大きさは100μ以下が好ましい。

以上述べた方法によって得られるαーアルミナ 粉末は、少くともその一次粒子群は球状多面体粒となっているが、これらの一次粒子の一部は凝集して存在しているため、これをさらにロッドミル或いはマラーおよびらいかい器形式の粉体処理装置で解砕することによって形状因子が 1.0~1.4 のαーアルミナ粉末を得ることができる。解砕時間は用いる処理装置等によって異なるが、一般的には 20~200分で十分である。また解砕条件

の円、乾式か湿式のいずれを選ぶかについては特に制限はないが、αーアルミナ粒に対する汚染を防止する意味に於いて、一般には乾式解砕の方が好ましい。

とのようにして得られるαーブルミナ粉末は種

(7)

イトライドおよび結晶性シリカのごとき充塡剤を 一種または二種以上を併用してもよい。

本発明のαーアルミナ粉末と高分子物質とを配 合するにあたり、配合物の使用目的に応じて安定 剂、加工性改良剂、加硫剂、加硫促進剂、加硫促 進助剤、スコッチ防止剤、難燃化剤および着色剤 のごとき添加剤を添加してもよい。該配合物を製 造するには一般に合成樹脂およびゴム業界におい て使われている混合方法を適用すればよいが、バ ンバリーミキサー、ロールミルおよび押出機のご とき混合機を使用して均一状に溶融混練する方法 が適当である。このようにして得られる配合物(組成物)はとれらの業界において用いられている 成形法(たとえば、押出法、射出成形法、プレス ・ 成形法)により、所望の形状に成形加工して使用 される。その一例として、放熱板に成形する場合 には、カレンダーロールおよびプレス機をどでシ - ト状に加工し、所望の寸法、形状に切り出した 後、使用される。

以下、実施例により本発明をさらにくわしく説

々の高分子物質(合成樹脂、ゴム状物)の配合剤 として使うことができる。これらの高分子物質の うち、シリコンゴム、塩素化ポリエチレンゴム、 弗素ゴムなどの耐熱性ゴムが好ましく、特にシリ コンゴムが好適である。

これらの高分子物質と本発明のαーアルミナ粉末とを混合して配合物(組成物)を製造するにあたり、高分子物質の種類によって異なるけれども、αーアルミナ粉末を全組成物の70~78容量がまで配合することができる。本発明のαーアルミナ粉末は以上のように高配合することができるから、組成物は熱伝導性がすぐれている。また、このように高配合しても、組成物は均一状であり、成形性もすぐれてかり、さらに機械的性質も満足し得るものである。

さらに、高分子物質との組成物を製造するにあたり、αーアルミナ粉末と高分子物質のみを混合することによって組成物が得られるけれども、組成物の使用目的に応じて組成物のその特性を損なわない範囲で、マグネシア、ベリリヤ、ボロンナ

(8)

明する。

をお、実施例および比較例において、熱伝導率 は得られたシートを迅速熱伝導計(昭和電工社製、 商品名 QTM-MD)を用い、室温下で測定し た。

実施例 1~3、比較例 1~3

ングロール(径 8インチ)を用いて3分間混練を行ない、シート状物を作成した。得られた各シート状物を170℃の温度において5㎏/cdの加圧下で10分間プレスを行なってプレスシート(厚さ 0.5 mm)を作成した。これらのシート200℃の温度においてギャーオープンを使って2時間キュアリングを行なった後、熱伝導性(熱伝導率)を測定した。それらの結果を第1表に示す。なお、第1表において、αーアルミナ粉末の容量のとは、得られた各シート状物中に占めるアルミナ(A)、アルミナ(B)およびアルミナ(O)の総容量のである。

(1)

第 1 3

実施例ま たは比較 例番号	配 合 量 (重量部)			~ ~ .			
	アルミナ (A)	アルミナ (B)	アルミナ (C)	マーアルミナ粉末の容 量を	(B) / (A)	(C) / ((A)+(B))	熱伝導率
比較例 1	400	400	400	7 4.7	1	0. 5	2. 3
" 2	300	3 0 0	600	"	1	1	2. 0
<i>"</i> 3	160	6 4 0	400	"	4	0.5	2. 2
夷施例 1	300	600	300	·· #	2	0.3	3. 1
<i>"</i> 2	200	800	200	"	4	0. 2	3. 0
" 3	600	300	300		0. 5	0.3	3. 2

1) K cal / m·時間·度

以上の実施例および比較例から、本発明によって得られる高分子物質用配合剤を高分子物質(とりわけ、耐熱性ゴム)に配合すれば、得られる組成物の熱伝導率がすぐれていることが明らかである。

特許出願人 昭和電工株式会社 代 理 人 弁理士 菊 地 精 一

(13)